

# 会议通知

为推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，促进机械工程、智能制造及制造等领域的技术创新与产业升级，第七届机械工程、智能制造与机电一体化学术会议将于2026年06月26-28日在中国·桂林召开。

会议将聚焦机械工程、智能制造、机电一体化及新材料新工艺技术等领域的最新发展动态与关键技术难题，邀请高校、企业及科研机构的专家学者共同探讨技术创新路径，推动产学研深度融合。

我们诚挚欢迎海内外相关领域的学者、工程师及行业专家踊跃投稿及参会，分享最新研究成果，交流关键技术突破，拓展合作机遇。期待与您相聚桂林，共话智能制造未来，携手推动行业高质量发展！

大会信息如下：

一、大会官网：[www.icmeimm.com](http://www.icmeimm.com)

二、会议信息：

会议主题：数智融合·万物智联·新质机电

时间：2026年6月26-28日

地点：中国·桂林·桂林电子科技大学·花江校区·第45教学楼51206报告厅

三、组织机构：

主办单位：

桂林电子科技大学、广西人工智能实验室、广西机械工程学会、桂林航天工业学院、广西制造系统与先进制造技术重点实验室、广西机器人智能感知与控制重点实验室、广西计算机学会

承办单位：

桂林电子科技大学机电工程学院、广西半导体芯片先进封装与系统集成重点实验室

协办单位：

广西汽车研究院、马来西亚国立大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、南方科技大学、华南理工大学、武汉理工大学、重庆大学、南京航空航天大学、广西大学、西安理工大学、安徽理工大学、北京工业大学、广东省科学院半导体研究所、广西机械工程学会智能制造分会、澳门科技文化交流协会

四、大会组委（排序不分先后）

大会主席

潘开林 教授 桂林电子科技大学

# 第七届机械工程、智能制造与机电一体化学术会议 (MEIMM2026)

2026 7<sup>th</sup> International Conference on Mechanical Engineering, Intelligent Manufacturing and Mechatronics

---

## 联合主席

岳洋 教授 西安交通大学

## 组织委员会主席

唐荣江 研究员 桂林电子科技大学

高兴宇 教授 广西民族大学

## 出版主席

莫秋云 教授 桂林电子科技大学

## 学术委员会主席

贺德强 教授 广西大学

柯熙政 教授 西安理工大学

## 组织委员会成员

杨道国 教授 桂林电子科技大学

龚雨兵 研究员 桂林电子科技大学

龙芋宏 教授 桂林电子科技大学

邓建新 教授 广西大学

何思亮 副教授 桂林电子科技大学

## 学术委员会成员

田艳红 教授 哈尔滨工业大学

何鹏 教授 哈尔滨工业大学

胡川 研究员 广东省科学院半导体研究所

王学文 教授 武汉理工大学

张平 教授 桂林电子科技大学

何水龙 教授 桂林电子科技大学

\*更多专家组委, 详见会议官网

## 五、报告嘉宾

张智军 教授 华南理工大学

刘志权 教授 南方科技大学

岳洋 教授 西安交通大学

Kim S Siow 副教授 马来西亚国立大学微工程与纳米电子学研究所 (IMEN)

代岩伟 教授 北京工业大学

章俊 教授 重庆大学

李保坤 教授 安徽理工大学

霍福鹏 副研究员 南京航空航天大学

(排名不分先后, 按照最终会议议程为准)

## 六、征稿主题：

**机械工程：**先进制造与增材制造、系统动力学与故障诊断、微纳制造与机器人装备

**智能制造：**数字孪生与智能工厂、AI 驱动的制造优化、工业互联网与人机协作柔性制造

**机电一体化：**智能控制与嵌入式系统、工业物联网与传感执行器、自适应控制与高端装备  
机电应用

**人工智能软硬件协同：**嵌入式 AI 与边缘智能、AIoT 融合应用、深度学习软硬件协同创新

### 【投稿须知】

1) 本次会议优先采用在线方式投稿，[在线投稿通道](#)。

(链接：<https://www.yanfajia.com/action/p/74LV94DR>)



2) 会议的官方语言为英语，中文稿件需翻译后再投递；如需翻译服务，可联系大会秘书。

3) 论文根据模板排版不得少于 6 页，模板请在会议资料处下载 ([论文模版](#))。

4) 论文录用后，请作者自费通过正规查重系统（推荐 Turnitin 或 iThenticate）对终稿进行全文查重（含参考文献）及 AI 率检测，全文（含参考文献）查重率不高于 25%，AI 生成内容检测报告不高于 20%。

5) 论文应为原创文章且从未公开发表，禁止抄袭，禁止一稿多投。

6) 根据 IOP 出版社规定，在同一会议的所有投稿中，每位作者署名文章不能超过两篇。请投稿前核对作者署名情况，超限稿件将不予录用或撤稿处理。

## 七、论文出版

MEIMM2026 所有的投稿都必须经过 2-3 位组委会专家审稿，经过严格的审稿之后，最终所有录用的论文将通过会议论文集出版，见刊后由出版社提交至 EI, Scopus 检索。

## 八、大会议程

2026 年 6 月 26 日 注册/报到

2026 年 6 月 27 日 开幕式/大会主旨报告/口头报告

2026 年 6 月 28 日 学术考察

第七届机械工程、智能制造与机电一体化学术会议 (MEIMM2026)  
2026 7<sup>th</sup> International Conference on Mechanical Engineering, Intelligent Manufacturing and Mechatronics

九、注册费用

类型	费用 (元)	备注说明:
论文投稿 (7 页内)	3400 元/篇	1. 参会报名: <a href="#">在线参会注册</a> 2. 学生及团体投稿/报名有优惠。 3. 每篇投稿文章可享有一位作者免费参会。 4. 注册费(含会务费/资料费), 会议期间交通费、食宿费自理。
学生投稿 (7 页内)	3200 元/篇	
超页费	300 元/页	
口头报告参会	1800 元/位	
听众参会	1500 元/位	

\*收款说明: 大会委托广州高博科技信息有限公司代收注册费/版面费并出具发票。

户名: 广州高博科技信息有限公司

帐号: 3602079109200345756

开户银行: 中国工商银行广州东晓支行

纳税人识别号: 91440105MACB395Q40

十、联系方式:

会议秘书: 季老师

微信/电话: 19128953460

邮箱: [icmeimm@163.com](mailto:icmeimm@163.com)

第七届机械工程、智能制造与机电一体化学术会议 (MEIMM2026) 组委会

